## (13th SPRUC Young Scientist Award 受賞 研究報告)

# 放射光を駆使した負熱膨張物質の多角的評価・物質設計

神奈川県立産業技術総合研究所 次世代半導体用エコマテリアルグループ 西久保 匠

#### Abstract

近年、熱膨張を制御する技術として負熱膨張物質が広く研究されている。本研究では圧力下で不連続な巨大体 積減少が起こる物質に着目し、放射光を活用した結晶構造・電子状態・ドメイン変化といった多角的な視点から 負熱膨張物性の評価を行った。このようなミクロスケールからマクロスケールまでの多角的な視点からの負熱膨 張物性の評価はメカニズムの理解のみならず材料設計にも有効であると示した。

#### 1. はじめに

航空宇宙分野など温度幅の広い環境下で用いられ る材料や、半導体製造など小さな変位でも致命的とな るような分野では、熱膨張による位置決めのずれや、 異種接合界面の剥離が大きな問題となる。そのため、 熱膨張を制御する技術が求められており、多くの研究 がなされている。この熱膨張抑制技術の一つとして、 負熱膨張物質の利用がある。構造材料と混合すること で熱膨張の抑制・制御ができる負熱膨張材料は様々な 産業分野での応用が期待されている。負熱膨張とい う物性は実は身近なものである。例えば、水の固相で ある氷が水面に浮くことは、液相よりも固相の密度が 低く、固相から液相に相転移する際に負熱膨張を伴う ことを表している。既に応用されている負熱膨張物質 としては、ガラスの熱膨張を補償している β-ユーク リプタイトなどが挙げられる。この数十年で多くの 負熱膨張材料が報告されており、特にペロブスカイト 構造とその関連構造(逆ペロブスカイト、ルドルスデ ン・ポッパー型層状ペロブスカイト、ReO。型構造な ど)を持つ化合物では多くの負熱膨張物質が報告され ており、これらは強誘電体から常誘電体への転移、金 属間電荷移動、磁気体積効果、軌道秩序転移、フレキ シブルネットワークなど、多種多様な起源を有してい る『ラーア。中でも近年注目されているのは、相転移による 大きな体積変化を利用した材料である。相転移型負熱 膨張では、低温相と高温相の体積変化量は物質によっ

て決まっているため、転移温度幅と熱膨張係数はトレ ードオフの関係となる。そこで、体積変化量が大きい 母物質を選んで、化学置換で相転移温度を調整するこ とになるが、この際、一般に体積変化量の減少を伴っ てしまう。また、一次相転移に起因する物質では体積 の大きい低温相と体積の小さい高温相がその分率を 温度の関数として変化することでなだらかな体積収 縮として利用できるが、どのようにこの2相共存状態 が安定化されるかは理解されていない。そこで本研究 では、電荷移動と極性-非極性転移の 2 つのメカニズ ムが同時に発現することで負熱膨張が増強される BiNi<sub>1</sub>,Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のデザインと、圧力下で極性-非極性相転 移によって体積の減少を示すペロブスカイト酸化物 PbVO。に着目し、最適なドープを施すことで巨大な体 積変化量を持つ負熱膨張物質を設計、その際の2相共 存状態を観察することでドメイン境界に大きな歪み が生じていることを見出した。

## 2.2 つのメカニズムが共存した負熱膨張物質の設計

6 GPa の高圧下で合成されるペロブスカイト型 BiNiO<sub>3</sub>は常圧でBi<sup>3+</sup><sub>0.5</sub>Bi<sup>5+</sup><sub>0.5</sub>Ni<sup>2+</sup>O<sub>3</sub>という特徴的な電荷 分布を持ち、Bi<sup>3+</sup>と Bi<sup>5+</sup>が柱状に秩序した 2 つの Bi サイトが存在する三斜晶 (*P*1) をとる<sup>[3]</sup>。圧力下では Bi<sup>5+</sup> と Ni<sup>2+</sup>の間で電荷移動が起き、Bi<sup>3+</sup>Ni<sup>3+</sup>O<sub>3</sub>の価数状態 へと変化し、Bi<sup>3+</sup>と Bi<sup>5+</sup>の電荷秩序が融けることで Bi サイトが 1 つの斜方晶 (*Pbnm*) への構造相転移を伴

う。さらに、Ni が 2+から 3+となることで、ペロブス カイト構造の骨格をなす NiO。八面体が収縮し、およ そ3%もの巨大な体積の収縮が起きる。Bi の一部を3 価のランタノイド<sup>®</sup>、または Ni の一部を Fe<sup>3+</sup>で置換す ると<sup>®</sup>、Bi<sup>3+</sup>Ni<sup>3+</sup>O<sub>3</sub>の価数状態が安定化されるため、昇 温によって Bi-Ni 間電荷移動が生じるようになる。こ の体積収縮を伴う三斜晶から斜方晶への相転移が、温 度によって相分率を変えながら、なだらかに起きるた め、両相の分率の重みを付けた平均格子体積が連続的 に収縮する負熱膨張が発現する。一方、代表的な強誘 電体である PbTiO<sub>3</sub>では、極性の構造を持つ強誘電相 から非極性の常誘電相への転移に伴い、電気分極によ る構造歪みが解消することで、およそ 1%の体積収縮 がおこることが知られている。我々の研究グループは すでに BiNi<sub>1×</sub>Fe<sub>x</sub>O<sub>3</sub>が x < 0.25 の領域でサイト間電荷 移動によって巨大な負熱膨張を示すことを明らかに してきた。しかしながら、Fe<sup>3+</sup>の置換量増加に伴い電 荷移動に寄与する Bi5+や Ni3+の、本研究では、この固 溶体について、Fe の置換量を増やすことで BiFeO<sub>3</sub>由 来の自発分極の誘発を目的とし、結晶構造と電子状態 の変化、熱膨張特性をさらに詳細に解析した。

図 1 に X 線回折パターンと硬 X 線光電子分光スペクトルを示す。x=0 での、 $Bi^{3+}$  と  $Bi^{5+}$  が柱状に秩序した、2 つの Bi サイトを持つ三斜晶相が、x=0.15 では Bi が 1 サイトの斜方晶構造へと変化し、x=0.3 では最終的に  $BiFeO_3$  と同様の極性構造の菱面体晶相へと転移することが明らかとなった。昇温すると、x<

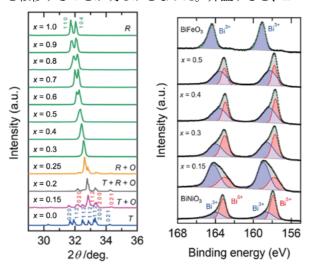


図 1 各組成の XRD パターン (左) と Bi4f の HAXPES スペクトル

0.25 までは、三斜晶から斜方晶への負熱膨張を伴う相転移が観測され、x>0.25 では菱面体晶から斜方晶への相転移を伴う相転移が観測された。硬X線光電子分光と PDF 解析の結果、x<0.15 でのメスバウアー分光の結果から、菱面体晶相は  $Bi^{3+}_{0.5(1+x)}Bi^{5+}_{0.5(1-x)}Ni^{2+}_{1-}$   $_x$ Fe $^{3+}_{x}O_3$ の電荷分布を取り、局所的には  $Bi^{3+}_{x}$ と  $Bi^{5+}$ が電荷秩序した構造であることが明らかとなった。

図 2 に菱面体晶相(緑)と斜方晶(赤)の擬立方格子体積とその相分率から求めた平均体積(黒)の温度依存(a)、相転移の際の体積変化量(b)、点電荷モデルから計算した自発分極値(c)を示す。x<0.2では電荷移動に関与する $Bi^{5+}$ と $Ni^{2+}$ の量が減少するため体積変化量が0に向かって減少していくが、 $0.20 \le x \le 0.40$ では自発分極値の増大に伴いその減少を打ち消すことができている。すなわち、 $0.20 \le x \le 0.50$ では、 $PbTiO_3$ と同様の、極性から非極性の結晶構造転移が電荷移動と同時に起こっており、そのために負熱膨張が増強されている。

#### 3. 巨大負熱膨張の設計とドメイン構造観察

高圧高温下で合成されるペロブスカイト型化合物  $PbVO_3$ は、 $Pb^{2+}$ の  $6s^2$ 孤立電子対の立体障害効果および  $d^1$ 電子配置を持つ  $V^{4+}$ による Jahn-Teller 効果によ

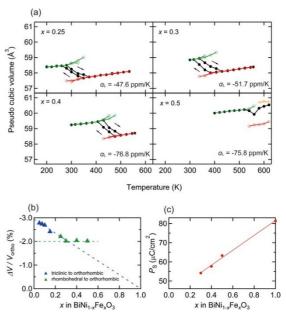


図2 (a) 各相の擬立方格子体積と相分率で重みづけした平均格子体積の温度変化、(b) 負熱膨張における体積減少量の組成依存、(c) 点電荷モデルから求めた菱面晶の自発分極値

り  $c/a\sim1.23$  という巨大な正方晶歪みをもち、高圧下で-10.6%という非常に大きな体積減少を伴う極性正方晶 (P4mm) から非極性立方晶 (Pm-3m) への構造相転移を示す[10-12]。  $Pb^{2+}$ サイトへの  $Bi^{3+}$ 置換により  $V^{4+}$ への電子ドープを行うことで、常圧下での昇温での負熱膨張を伴う構造相転移が観測され、さらに  $Bi^{3+}$ 、  $La^{3+}$ の両置換により、負熱膨張の動作温度を室温域まで低減可能であることが報告されている[13]。 しかしながら、この電子ドープは c/aの低下を招くことから体積変化量の減少を伴うものである。そこで、 $Pb^{2+}$ や  $Bi^{3+}$ の持つ  $6s^2$  孤立電子対の量を調節することで大きなc/aを保ちつつ温度誘起相転移を狙い、巨大な体積変化を伴う負熱膨張物質の設計を図るとともに低温相と高温相の 2 相のドメインを観察した。

 $Pb_{L}M_xVO_3$  (M=Bi,Sr,La) を合成したところ、電子ドープした Bi、La 置換試料では c/a比が減少していることを示している。 $Sr^2$  置換の場合、c/aはほとんど変わらず、x=0.18 で  $PbVO_3$  の高圧安定相である立方相への相転移が急激に起こることが確認された。これらのことから、 $PbVO_3$ の c/a は電子ドープ量によって支配され、 $6s^2$  孤立電子対の量は相転移温度を低下させると考えられる。c/a比が小さいと正味の体積収縮率 ( $\Delta VV$ ) が小さくなるため、大きな負熱膨張

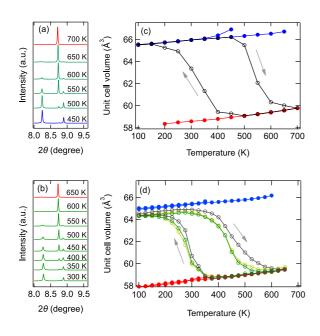


図 3 (a、c) Pb<sub>0.8</sub>Bi<sub>0.1</sub>Sr<sub>0.1</sub>VO<sub>3</sub> と (b、d) Pb<sub>0.775</sub>Bi<sub>0.125</sub>Sr<sub>0.1</sub>VO<sub>3</sub> の各温度での XRD パターン と負熱膨張特性

を実現するには大きな c/a 比が必要である。大きな体 積収縮率を保ちつつ負熱膨張を実現するために、c/a が大きく、温度誘起相転移のない Pb<sub>0.9</sub>Bi<sub>0.1</sub>VO<sub>3</sub> と Pb<sub>0.875</sub>Bi<sub>0.125</sub>VO<sub>3</sub>を選択し、Pb の Sr 置換により正方晶 相の不安定化を図った。このように設計された  $Pb_{0.8}Bi_{0.1}Sr_{0.1}VO_3$  と  $Pb_{0.775}Bi_{0.125}Sr_{0.1}VO_3$ は図 3 (a)、(b) に示すように低温で青で示す正方晶だったものが加 熱により 2 相が共存して赤で示す立方晶相へ一次相 転移し、相分割率で重み付けした平均単位胞体積は大 きな体積収縮を示している。PbasBiaSraVO3と Pb<sub>0.775</sub>Bi<sub>0.125</sub>Sr<sub>0.1</sub>VO<sub>3</sub>では、同じ温度での低温相と高温相 の体積差はそれぞれ11.1%と10.8%と非常に大きく、 PbVO<sub>3</sub>の圧力誘起体積収縮の 10.6%に匹敵する値と なった。結晶学的な体積変化量は 9.3%と 8.4%に達 し、相転移型負熱膨張材料の中で最も大きいものであ る。Pb<sub>0.775</sub>Bi<sub>0.125</sub>Sr<sub>0.1</sub>VO<sub>3</sub>について、5 回の加熱-冷却サ イクルの XRD パターンの温度変化を測定した。大き な体積収縮は維持され、温度ヒステリシスは5回目の 温度サイクルで 200 K から 150 K に減少することが わかった(図3(d))。加熱/冷却サイクルを繰り返す ことでドメイン構造が変化し、温度ヒステリシスが抑 制されると考えられる。そのため、温度変化で2相の 分率が変化しない PboseSols VO3 を用いて、高角散乱環 状暗視野走査透過電子顕微鏡(HAADF-STEM)で観 察したところ、相境界のような構造が確認できた(図 4 (a))。領域 b および c のフーリエ変換像から、領域 d は a = 0.37 nm、c = 0.45 nm の正方晶相、領域 e は a = c = 0.38 nm の立方晶相であり、これらの格子 定数は、放射光X線回折データのリートベルト解析の 結果とよく一致する。観察された立方体状の相は001 方向から見た正方晶相である可能性もあるが、正方晶 -正方晶ドメインは前述のように 90°ドメインを形成 した方が安定なので、正方晶-立方晶の境界が観察さ れたと結論づけられる。(d) に示すドメイン境界の拡 大図から、正方晶相と立方晶相は{110}面を共有して 境界を接しているが、{101}。面と{110}。面の間隔はそ れぞれ 0.291 nm と 0.262 nm で 10%の差があり、 10 間隔ごとに欠陥が導入されてミスマッチが緩和さ れていると推測される。(d) の緑破線で示した刃状転 移の余剰半面は11セルに1個の周期で見られる。

このように電子顕微鏡像から見られる視野は非常

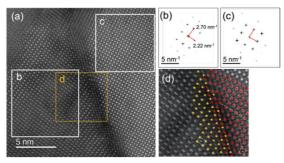


図 4 STEM によるドメイン観察 (a) 広視野での像、 (b、c) 各領域での FFT 像、(d) 分域付近の拡大 像、黄色の点は正方晶、赤色の点は立方晶を示す

に狭く、粒子全体のドメインを観察することはできな いが、Bragg コヒーレント X 線回折イメージング (BCDI) では 1 粒子に着目してドメイン構造と歪み を 3 次元的に可視化することができる[14, 15]。 図 5 (a) は、立方晶 200 の 3 次元ブラッグ回折パターンを観 察したものである(スペックル)。ブラッグ位置から散 乱ベクトル $Q_m$ に垂直に伸びる筋状のテールは、 $Q_m$ に垂直な法線ベクトルを持つ界面の存在を、ストリー ク状のスポットの間隔 0.0045 nm<sup>-1</sup> は、粒子外径が 220 nm であることを示している。これは (d) に示 した位相回復像のサイズと一致する。(b) は、(a) の 断面の高速フーリエ変換 (FFT) 像である。FFT 像は 粒子画像の自己相関関数に相当するため、(c) に模式 的に示すように、縦縞は複数の界面が平行に存在して いることを示している。前述の HAADF-STEM 像は、  $Q_{200}$ 方向に対応している。(d) は、(a) のデータを用 いて位相差計算を行い、粒子の三次元像を再構成した ものである。内部の等密度面は、立方晶 200 の反射密 度が高い領域を示している。(e)、(f) に示す Bragg-CDI 像の断面図は、(c) に示すように、011-接続界面 と平行で $Q_m$ 方向と垂直な方向から見たものである。 (d) の水平面における立方晶 200 の反射密度をプロ ットしたものが (e) である。立方晶と正方晶が滑らか に接続するためには、弾性エネルギーが最小となる [110]接続となると考えられる<sup>[16]</sup>。また、立方晶密度の 高い領域に挟まれた立方晶密度の低い領域は、他の相、 すなわち正方晶で満たされていると考えるのが妥当 である。図5(f)は断面位相像を示しており、位相変 化が大きいことが境界部にひずみがあることを示し ている。相変化の縞模様は垂直であり、(e) の点線で 囲った立方晶密度の高い部分と重ね合わせると位相

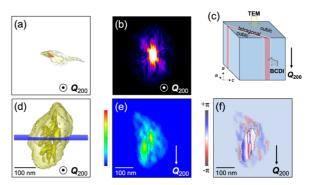


図5 BCDI による粒子内のドメイン構造の観察 (a) スペックル、(b) スペックルの FFT 像、(c) TEMで観察した方向との相関図、(d) 立方晶 200 密度分布、(e) 断面での立方晶密度、(f) 断面での位相像

差の大きい部分が2相の境界に対応することから、この位相差は正方晶-立方晶間のひずみによるものであるとわかる。このことから、前述のPb<sub>0.775</sub>Bi<sub>0.125</sub>Sr<sub>0.1</sub>VO<sub>3</sub>では加熱/冷却サイクルによりこのドメイン構造が変化し、温度ヒステリシスが抑制されたと示唆される。

## 4. まとめと今後の展開

本研究では圧力下で不連続な巨大体積減少が起こ る物質に着目し、放射光を活用した負熱膨張物質の詳 細な結晶構造・電子状態・ドメイン変化といった多角 的な視点からそのメカニズムを解明から物質のデザ インまで行った。物質デザインとしては、電荷移動相 転移により圧力下で3%もの体積収縮を示すBiNiO3 と、圧力下で1%の体積収縮を示す強誘電体BiFeO。と の固溶体を合成し、その評価を BL02B2 を用いた放射 光 X 線回折、BL22XU を用いた放射光 X 線全散乱デ ータから得た原子二対相関関数 (PDF) 解析、さらに は BL09XU および BL47XU を用いた硬 X 線光電子 分光実験により行うことで、2つのメカニズムを併せ 持つ負熱膨張物質を設計した。また、強誘電相から常 誘電相への相転移による負熱膨張に着目し、一軸加圧 による強弾性ドメインの大きな変化を、BL02B2を用 いた放射光X線回折による観察を行い、さらには最大 の体積変化量を持つ負熱膨張物質のデザインと BL22XU でのブラッグコヒーレント X 線回折イメー ジングと電子顕微鏡像によるドメイン観察を行った。 BL10XU での高圧下 X 線回折実験から求めた圧縮曲 線から、相転移により引き起こされる負熱膨張の2相

共存状態がドメイン境界に働く応力により安定化されることを明らかにした。このように放射光を駆使して結晶構造・局所構造・電子状態といったミクロなものからドメイン構造といったマクロなものまで多角的な視点から負熱膨張物性とメカニズムを評価し物質デザインが有効であると示した。今回得られた物質はいずれも高圧下で合成されるものであるが、メカニズムを詳細に調査し、生成過程を観察することで、より簡便な手法で合成できる物質の探索や産業化可能なプロセスの開発を進めていきたい。

## 謝辞

共同研究者である東京科学大学の東正樹 教授、 QST の綿貫徹 博士、大和田謙二 博士、町田晃彦 博士、押目典宏 博士、熊本大学の水牧仁一朗 教授、早稲田大学の溝川貴司 教授に多大な協力をいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

## 参考文献

- [1] K. Takenaka : Sci. Technol. Adv. Mater. 13 (2012) 013001.
- [2] H. Schulz: J. Am. Ceram. Soc. 57 (1974) 313-318.
- [3] M. Azuma, W. Chen, H. Seki, M. Czapski, S. Olga, K. Oka, M. Mizumaki, T. Watanuki, N. Ishimatsu, N. Kawamura: *Nat. Commun.* 2 (2011) 347.
- [4] K. Takenaka, H. Takagi : Appl. Phys. Lett. 87 (2005) 261902.
- [5] Y.W. Long, N. Hayashi, T. Saito, M. Azuma, S. Muranaka, Y. Shimakawa: *Nature* 485 (2009) 60.
- [6] B.K. Greve, K.L. Martin, P.L. Lee, P.J. Chupas, K.W. Chapman, A.P. Wilkinson : *J. Am. Chem. Soc.* 132 (2010) 15496-15498.
- [7] K. Takenaka, Y. Okamoto, T. Shinoda, N. Katayama, Y. Sakai: *Nat. Commun.* **8** (2017) 14102.
- [8] K. Oka, K. Nabetani, C. Sakaguchi, H. Seki, M. Czapski, Y. Shimakawa and M. Azuma: Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 061909.
- [9] K. Nabetani, Y. Muramatsu, K. Oka, K. Nakano, H. Hojo, M. Mizumaki, A. Agui, Y. Higo, N. Hayashi, M. Takano and M. Azuma: Appl. Phys. Lett. 106 (2015)

061912.

- [10] A.A. Belik, M. Azuma, T. Saito, Y. Shimakawa, M. Takano: Chem. Mater. 17 (2005) 269-273.
- [11] R.V. Shpanchenko, V.V. Chernaya, A.A. Tsirlin, P.S. Chizhov, D.E. Sklovsky, E.V.Antipov, E.P. Khlybov, V. Pomjakushin, A.M. Balagurov, J.E. Medvedeva, et al.: Chem. Mater. 16 (2004) 3267-3273.
- [12] K. Oka, T. Yamauchi, S. Kanungo, T. Shimazu, K. Ohishi, Y. Uwatoko, M. Azuma, T. Saha-Dasgupta : *J. Phys. Soc. Jpn.* 87 (2018) 024801.
- [13] H. Yamamoto, T. Imai, Y. Sakai, M. Azuma: Angew. Chem. Int. Ed. 57 (2018) 8170-8173.
- [14] K. Ohwada, K. Sugawara, T. Abe, T. Ueno, A. Machida, T. Watanuki, S. Ueno, I. Fujii, S. Wada, Y. Kuroiwa: Jap. J. Appl. Phys. 58 (2019) SLLA05.
- [15] N. Oshime, K. Ohwada, K. Sugawara, T. Abe, R. Yamauchi, T. Ueno, A. Machida, T. Watanuki, S. Ueno, I. Fujii, S. Wada, R. Sato, T. Teranishi, M. Yamauchi, K. Ishii, H. Toyokawa, K. Momma, Y. Kuroiwa: *Jap. J. Appl. Phys.* 60 (2021) SFFA07.
- [16] W. Cao, L. E.Cross: Phys. Rev. B 44 (1991) 5-12.

## 西久保 匠 NISHIKUBO Takumi

神奈川県立産業技術総合研究所 次世代半導体用エコマテリアルグループ 〒243-5198 神奈川県海老名市下今泉 705-1

TEL: 045-924-5342

e-mail: tnishikubo@msl.titech.ac.jp